

MES 2011 プログラム		9月8日(木)	
	A 会場	B 会場	C 会場
10:20	<b>【1A1】 ナノマテリアル</b> 1. 樹脂/金属間におけるナノ構造界面の構築と樹脂上への金属パターン形成 ○福本ユリナ, 谷山智紀, 鶴岡孝章, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学) 2. 高熱伝導性 Ag/カーボンナノチューブ複合材料の開発 ○井上雅博 <sup>1</sup> , 林 大和 <sup>2</sup> , 山田雄大 <sup>2</sup> , 滝澤博胤 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 大阪大学, <sup>2</sup> 東北大学) 3. Ag フレークを用いた低温接合用ダイボンディング材料 ○坂元創一, 菅沼克昭 (大阪大学) 4. 耐マイグレーション性配線材料としての銀-銅複合ナノ粒子 ○柏木行康 <sup>1</sup> , 山本真理 <sup>1</sup> , 斉藤大志 <sup>1</sup> , 大野敏信 <sup>1</sup> , 垣内宏之 <sup>2</sup> , 吉田幸雄 <sup>2</sup> , 中許昌美 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 大阪市立工業研究所, <sup>2</sup> 大研化学製造販売)	<b>【1B1】 回路基板 I</b> 1. パラジウムナノ粒子/ポリマーハイブリッド層を利用したプラスチックフィルム表面上の銅配線形成 ○玉井聡行, 渡辺 充, 渡瀬星見, 松川公洋 (大阪市立工業研究所) 2. エチレンジアミン錯体浴からの ITO 透明導電膜上への直接銅電析 ○有村英俊 <sup>1,3</sup> , 鶴岡孝章 <sup>2</sup> , 赤松謙祐 <sup>2</sup> , 縄舟秀美 <sup>2</sup> , 川端 愛 <sup>3</sup> ( <sup>1</sup> 甲南大学大学院, <sup>2</sup> 甲南大学, <sup>3</sup> 石原薬品) 3. めっきプロセスに対する導体ペーストのガラス成分が及ぼす影響 ○長尾由起, 村橋浩一郎, 津野勇輝, 田邊靖博 (奥野製薬工業) 4. 第4高調波 YAG レーザを用いた小径ピア加工技術の開発 ○飯野正和 (京セラ SLC テクノロジー)	<b>【1C1】 検査技術</b> 1. TFT 配線における磁気結合方式に基づく短絡欠陥位置特定手法 ○羽森 寛, 坂和正敏, 片桐英樹, 松井 猛 (広島大学大学院) 2. リチウムイオン電池向け R2R フィルムのバリ検査技術開発 ○松村淳一, 常吉 豪, 大美英一, 谷川央樹 (東レエンジニアリング) 3. 生産現場における全数自動検査のための高速 CT 検査技術 ○杉田信治, 益田真之, 村上 清, 加藤訓之 (オムロン) 4. 吸引型マイクロ CT による CO <sub>2</sub> レーザ融着光ファイバの構造評価 ○小池真司 <sup>1</sup> , 浅川修一郎 <sup>1</sup> , 小林潤也 <sup>1</sup> , 上杉健太郎 <sup>2</sup> , 竹内晃久 <sup>2</sup> , 星野真人 <sup>2</sup> , 鈴木芳生 <sup>2</sup> , 渡辺義夫 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 日本電信電話, <sup>2</sup> 高輝度光科学研究センター)
11:40 12:40	休 憩		
12:40	<b>【1A2】 先端材料 I</b> 1. 無色透明な耐熱樹脂の合成と性質—ノルボルナン構造の脂環式ポリイミド— ○松本利彦 (東京工芸大学) 2. In-situ 重合により調製した透明エポキシ/ジルコニアハイブリッド体の光学および熱的性質 ○越智光一, 新居大輔, 原田美由紀 (関西大学) 3. 光インターコネク用硬化性液状樹脂 ○大森健太郎, 佐藤哲夫, 日高基彦, 縄田秀行 (日産化学工業) 4. 環境対応材料高分子アクチュエータの開発 東野雄樹, ○中井隆品, 植原勇介, 片岡拓也, 福本貴宏, 井上雅隆, 犬塚雄介, 大西克己, 田實佳郎 (関西大学大学院) 5. ハイブリッド高透磁率材料 ○松村和行, 松葉 聡, 新関彰一, 朝日 昇, 野中敏央 (東レ)	<b>【1B2】 回路基板 II</b> 1. プリント配線近傍に生じる静電容量を用いた欠陥検出システムに関する研究 ○野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊, 富田英雄 (東京電機大学) 2. ベルオキシソニ硫酸アンモニウム溶液による銅のエッチング速度に結晶構造が及ぼす影響 ○久保田賢治 <sup>1,2</sup> , 新山貴士 <sup>1</sup> , 松本克才 <sup>3</sup> , 吉原佐知雄 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 宇都宮大学大学院, <sup>2</sup> 三菱マテリアル, <sup>3</sup> 八戸高等専門学校) 3. 急速液置換による銅めっき用有機系添加剤の吸着挙動解析 ○宮本 豊, 服部 直, 岡本尚樹, 齊藤文靖, 近藤和夫 (大阪府立大学大学院) 4. ダイレクトメタリゼーション法により作製した透明ポリイミドフィルム上の銅めっき皮膜の密着強度 ○池田慎吾 <sup>1</sup> , 小林靖之 <sup>1</sup> , 藤原 裕 <sup>1</sup> , 赤松謙祐 <sup>2</sup> , 縄舟秀美 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 大阪市立工業研究所, <sup>2</sup> 甲南大学) 5. ITO のハイブリッド成膜の開発 ○稲葉和久, 田中英樹, 安部真司, 土門孝彰 (TDK)	<b>【1C2】 評価シミュレーション I</b> 1. モジュール製品の反りシミュレーション技術の開発 ○橋本 健, 川端孝弘, 乙脇康夫, 谷本靖忠 (村田製作所) 2. 光トランシーバにおける熱解析シミュレーションと電磁界シミュレーションを活用した解析手法の提案 ○石井邦幸, 大森寛康, 倉島宏実 (住友電気工業) 3. nMOSFET における 1 軸応力の影響評価 ○小金丸正明 <sup>1</sup> , 多田直弘 <sup>2</sup> , 池田 徹 <sup>2</sup> , 宮崎則幸 <sup>2</sup> , 友景 肇 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 福岡県工業技術センター, <sup>2</sup> 京都大学大学院, <sup>3</sup> 福岡大学) 4. Pre-Applied アンダーフィルプロセスに対する構造解析シミュレーション ○岡本圭司, 鳥山和重, 松本圭司, 折井靖光 (日本アイ・ピー・エム)
14:20			

A 会場		【セッション会場】 A 会場: ホール 1 B 会場: ホール 2 C 会場: 第 4, 5, 6 会議室
14:30	MES 2010 表彰式 ・ベストペーパー賞	
14:45	・研究奨励賞	
14:50	招待講演 1. 低温接合からみた環境対応実装技術 須賀唯知 (東京大学大学院 教授) 2. 半導体の一大転換期が来た～省エネがすべてのキーワード～ 泉谷 渉 (産業タイムズ社 代表取締役社長)	
16:50		

17:00	交流会 会 場: レストラン「紫紺」(100 周年記念会館 3 階) *参加費は別途必要です。
19:00	

	A 会場	B 会場	C 会場
9:10	<b>【2A1】先端材料 II</b> 1. 構造制御による液晶性エポキシ/BN 充填系の高熱伝導化 ○原田美由紀, 濱浦奈々, 安藤純一郎, 越智光一(関西大学) 2. 可溶性 LCP を用いた高放熱基板の開発 ○岡本 敏 <sup>1</sup> , 根津秀明 <sup>1</sup> , 宮越 亮 <sup>1</sup> , 近藤剛司 <sup>1</sup> , 水野克美 <sup>2</sup> , 夏目 豊 <sup>2</sup> , 小林康良 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 住友化学, <sup>2</sup> 日本発条) 3. 種々のフィラーを含有する熱伝導性接着剤の熱輸送特性における伝導電子の寄与 ○井上雅博 <sup>1</sup> , 牟田浩明 <sup>2</sup> , 山中伸介 <sup>2</sup> , リュウヨハン <sup>3</sup> ( <sup>1</sup> 大阪産業科学研究所, <sup>2</sup> 大阪大学大学院, <sup>3</sup> チャルマース工科大学) 4. 導電接着剤における電極間導電経路の3次元可視化 ○荒尾 修, 新帯 亮, 杉浦昭夫(デンソー) 5. 高分子光弾性センサ ○高井恭平 <sup>1</sup> , 黒田慎太郎 <sup>1</sup> , 木下俊輔 <sup>1</sup> , 中嶋康人 <sup>1</sup> , 上村裕輝 <sup>1</sup> , 森田哲也 <sup>1</sup> , 高和宏行 <sup>2</sup> , 村木可苗 <sup>2</sup> , 守本 雄 <sup>2</sup> , 築地光雄 <sup>2</sup> , 田實佳郎 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 関西大学大学院, <sup>2</sup> ユニオプト)	<b>【2B1】めっき技術</b> 1. ジアリルアミン系レベラーを用いた銅穴埋めめっき ○阿南善裕 <sup>1</sup> , 竹内 実 <sup>1,2</sup> , 岡本尚樹 <sup>1</sup> , 齊藤文靖 <sup>1</sup> , 文屋 勝 <sup>2</sup> , 近藤和夫 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 大阪府立大学, <sup>2</sup> 日東紡績) 2. 無電解 Ni/Pd/Au めっき皮膜のはんだ実装信頼性と Ni めっき皮膜中に共析した微量添加剤 (Pb, S) 濃度の関係 ○土田徹勇起 <sup>1</sup> , 大久保利一 <sup>1</sup> , 狩野貴宏 <sup>2</sup> , 荘司郁夫 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 凸版印刷 総合研究所, <sup>2</sup> 群馬大学大学院) 3. 電解めっきによる Sn-Cu 系合金の形成と膜特性評価 ○西村清賢 <sup>1</sup> , 井上史大 <sup>1</sup> , 清水智弘 <sup>1</sup> , 照井通文 <sup>2</sup> , 新宮原正三 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 関西大学, <sup>2</sup> 情報通信研究機構) 4. 耐硫化性および耐熱性に優れた LED 照明用積層構造 ○青木智美 <sup>1</sup> , 片山順一 <sup>1</sup> , 縄舟秀美 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 奥野製薬工業, <sup>2</sup> 甲南大学)	<b>【2C1】通信・伝送</b> 1. メタマテリアル技術を応用した EBG 構造の検討—ピアレス EBG 構造による電源系ノイズ抑制— ○上谷 純, 城田健一, 八木貴弘, 中澤哲夫(沖プリンテッドサーキット) 2. 差動伝送線路を対象とした平衡度不整合モデルによるコモンモード電流予測法の検証 ○松嶋 徹 <sup>1</sup> , 渡辺哲史 <sup>2</sup> , 豊田啓孝 <sup>3</sup> , 古賀隆治 <sup>3</sup> , 和田修己 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 京都大学大学院, <sup>2</sup> 岡山県工業技術センター, <sup>3</sup> 岡山大学大学院) 3. 微細 Au バンプを用いた接続構造体の信号伝送特性評価 ○安 陽太郎 <sup>1,2</sup> , 菊地克弥 <sup>2</sup> , 加藤史樹 <sup>2</sup> , 根本俊介 <sup>2</sup> , 仲川 博 <sup>2</sup> , 越地耕二 <sup>1</sup> , 青柳昌宏 <sup>1,2</sup> ( <sup>1</sup> 東京理科大学, <sup>2</sup> 産業技術総合研究所) 4. 発表中止
10:50			
11:00	<b>【2A2】基板材料</b> 1. ハロゲンフリー難燃性カバーレイ用エポキシ/リン含有フェノキシ系接着剤の特性(依頼講演) ○横山直樹, 雨澤 修, 会田勝之(新日鐵化学) 2. ポリイミドフィルムへの無電解めっきと微細配線の形成 ○横沢伊裕, 番場啓太, 三浦 徹, 幸田政文(宇部興産) 3. 超低 CTE 材料を用いた機能性低 CTE 複合基板 ○土屋俊之 <sup>1</sup> , 岡本 淳 <sup>1</sup> , 前田郷司 <sup>1</sup> , 塚田 裕 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 東洋紡績, <sup>2</sup> PACKS) 4. 狭ピッチ回路の無電解めっき技術 ○金子美晴, 小山 稔, 富山浩二(レイテック)	<b>【2B2】封止材</b> 1. SiP 用高信頼性 MUF (Mold-Underfill) 材と封止プロセス技術 ○石川有紀, 永井孝一良, 奥野敦史(サンユレック) 2. アンダーフィル樹脂のフィレット形成とチップ保護性の検討 ○澤田祐子 <sup>1</sup> , 阿部 剛 <sup>2</sup> , 齊藤隆幸 <sup>3</sup> , 徳永宗治 <sup>3</sup> ( <sup>1</sup> 三菱電機, <sup>2</sup> メルコセミコンダクタエンジニアリング, <sup>3</sup> ルネサスエレクトロニクス) 3. 次世代半導体パッケージ用材料システムの検討 ○竹越正明, 鈴木直也, 尾瀬昌久, 池内孝敏(日立化成工業) 4. 鉛フリーに対応したエリアレイ型フリップチップのファインピッチ化による信頼性への影響 ○大野英司(日本アイ・ピー・エム)	<b>【2C2】パワーエレクトロニクス</b> 1. 電磁界共鳴を用いたワイヤレス電力伝送の検討 ○今野宗一郎, 山本隆彦, 越地耕二(東京理科大学) 2. SPICE シミュレータによる単相フルブリッジインバータ回路のノイズ解析 ○桐畑美耶 <sup>1</sup> , 高橋成正 <sup>2</sup> , 柳田 進 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> ライズコーポレーション, <sup>2</sup> 日本アイ・ピー・エム) 3. SiC デバイスの特長を活かす高パワー密度, 高信頼性を実現するパワーモジュール構造 ○梨子田典弘, 堀尾真史, 飯塚祐二, 日向裕一郎, 池田良成, 高橋良和(富士電機) 4. 高熱伝導性銀接着剤 ○塩井直人(ハリマ化成)
12:20			
休 憩			
13:20	<b>【2A3】JEITA 電子部品技術ロードマップ 2011 実装技術ロードマップ 2011 概要報告</b> (13:20~14:00) 1. 電子部品から見た注目電子機器市場の動向 石井浩一(TDK-EPC) (14:00~14:30) 2. 電子部品技術ロードマップから見た主要電子部品の動向(LCR) 梶田 栄(村田製作所) (14:30~15:00) 3. その他電子部品技術の動向(コネクタ/入出力デバイス) 松尾秀治(アルプス電気)	<b>【2B3】評価シミュレーション II</b> 1. フリップチップのはんだ接続部のエレクトロマイグレーション解析と放射光 X 線 CT 観察 ○谷江尚史 <sup>1</sup> , 藤原伸一 <sup>1</sup> , 千綿伸彦 <sup>2</sup> , 藤吉 優 <sup>2</sup> , 新谷寛 <sup>1</sup> , 春別府 佑 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 日立製作所, <sup>2</sup> 日立金属) 2. プリント配線板の IVH (Interstitial Via Hole) における熱疲労寿命のばらつきに関する解析的検討 ○竹中国浩 <sup>1,2</sup> , 于 強 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 安川電機, <sup>2</sup> 横浜国立大学) 3. 鉛フリーはんだ材の結晶異方性に関する検討 ○瀬戸山大吾, 池畑秀哲, 長廻尚之, 鈴木智博(豊田中央研究所) 4. PBGA の熱特性測定と過渡シミュレーションモデルによる温度プロファイル定義 ○山田靖治(日本アイ・ピー・エム) 5. 小型半導体パッケージの微小剥離による熱抵抗変化 ○崔 雲, 江村 直之, 友景 肇(福岡大学)	<b>【2C3】EMI</b> 1. 三次元集積システムへ向けたキャパシタ内蔵インターポーザによる電源ノイズ抑制効果 ○菊地克弥 <sup>1</sup> , 秋山 豊 <sup>2</sup> , 島倉 啓 <sup>3</sup> , 竹村浩一 <sup>3</sup> , 五明利雄 <sup>3</sup> , 大久保利一 <sup>3</sup> , 小山鉄也 <sup>3</sup> , 村上朝夫 <sup>3</sup> , 青柳昌宏 <sup>1</sup> , 大塚寛治 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 産業技術総合研究所, <sup>2</sup> 明星大学, <sup>3</sup> ASET) 2. チップの電源等価回路を用いた EMI 解析手法の検討 ○海谷清彦 <sup>1</sup> , 金子俊之 <sup>1</sup> , 富島敦史 <sup>2</sup> , 須藤俊夫 <sup>3</sup> ( <sup>1</sup> トッパン NEC サーキットソリューションズ, <sup>2</sup> 東芝, <sup>3</sup> 芝浦工業大学) 3. 電源供給系のトランスファー・インピーダンス低減によるプリント基板からの放射ノイズ抑制手法 ○本木浩之, 中西秀行, 田中顕裕(アイカ工業) 4. 真空印刷法による高周波部品のシールド工法 ○小国隆志(東レエンジニアリング)
15:00	(15:00~15:20 休憩)		
15:10	(15:20~16:10) 4. 実装技術ロードマップから見た実装技術の動向 本多 進(NPO 法人 サーキットネットワーク) (16:10~16:50) 5. 実装技術ロードマップ(トピックス): 環境対応実装技術の動向 青木正光(NPO 法人 日本環境技術推進機構)	<b>【2B4】先端パッケージ</b> 1. 薄化シリコンチップの接合法 ○末岡邦昭, 堀部晃宏, 佐久間克幸, 阿部由之, 宮崎忠一, 山田文明, 折井晴光(超先端電子技術開発機構) 2. 無電解バリアメタルを用いたオールウェット Cu-TSV の形成と評価 ○有馬良平, 井上史大, 三宅浩志, 清水智弘, 新宮原正三(関西大学) 3. 部品内蔵配線板を応用した 3 次元実装モジュールの開発 ○勝原康彦, 荒木 登, 笹岡賢司, 豊吉令歌(大日本印刷) 4. TMV-POP 実装に用いる転写材料の開発 ○宗像宏典, 圓尾弘樹, 境 忠彦(パナソニックファクトリーソリューションズ) 5. 表面活性化接合および微細嵌合構造を用いたポリマー MEMS の実装に関する研究 ○天谷 諭, ダオ ベトズン, 杉山 進(立命館大学)	<b>【2C4】はんだ接合</b> 1. 界面反応層構造に及ぼす Ni 添加の影響 ○山内 啓(北海道大学大学院) 2. Sn-Bi 系はんだを用いた BGA 接合部の耐衝撃性向上に及ぼす Sb 添加の効果 ○岡本主史郎 <sup>1</sup> , 今泉延弘 <sup>1</sup> , 赤松俊也 <sup>1</sup> , 作山誠樹 <sup>1</sup> , 上西啓介 <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 富士通研究所, <sup>2</sup> 大阪大学大学院) 3. Au-Ge 半田/Ni(P) 接合界面の微細構造 ○郎 豊群, 山口 浩, 佐藤 弘(産業技術総合研究所) 4. エレクトロマイグレーション現象における実効原子価算出方法の検討 ○藤吉 優 <sup>1</sup> , 千綿伸彦 <sup>1</sup> , Jung Kyu Hau <sup>2</sup> , Daechul Choi <sup>2</sup> , King-Ning Tu <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> 日立金属, <sup>2</sup> UCLA) 5. 融点変化型低温接合材料の実装検討 ○北嶋雅之 <sup>1</sup> , 八木友久 <sup>2</sup> , 伊達仁昭 <sup>2</sup> , 山上高豊 <sup>1</sup> , 久保田 崇 <sup>1</sup> , 吉良秀彦 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 富士通アドバンステクノロジー, <sup>2</sup> 富士通クオリティ・ラボ)
16:50			